



## 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2024年2月14日

上場会社名 株式会社フェローテックホールディングス 上場取引所 東  
コード番号 6890 URL <https://www.ferrotec.co.jp>  
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 賀 賢漢  
問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役副社長 (氏名) 山村 丈 TEL 03-3281-8186  
四半期報告書提出予定日 2024年2月14日 配当支払開始予定日 -  
四半期決算補足説明資料作成の有無: 無  
四半期決算説明会開催の有無: 無

(百万円未満切捨)

### 1. 2024年3月期第3四半期の連結業績 (2023年4月1日～2023年12月31日)

#### (1) 連結経営成績 (累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年3月期第3四半期	168,266	8.1	20,926	△21.8	23,266	△34.1	13,464	△43.3
2023年3月期第3四半期	155,690	65.7	26,743	65.2	35,281	94.0	23,737	10.7

(注) 包括利益 2024年3月期第3四半期 39,345百万円 (△20.5%) 2023年3月期第3四半期 49,459百万円 (69.5%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年3月期第3四半期	286.76	261.82
2023年3月期第3四半期	518.21	506.07

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2024年3月期第3四半期	508,676	282,249	41.2	4,457.19
2023年3月期	410,648	249,656	44.7	3,916.07

(参考) 自己資本 2024年3月期第3四半期 209,542百万円 2023年3月期 183,729百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年3月期	-	50.00	-	55.00	105.00
2024年3月期	-	50.00	-	-	-
2024年3月期 (予想)	-	-	-	50.00	100.00

(注) 直前に公表されている配当予想からの修正の有無: 無

3. 2024年3月期の連結業績予想（2023年4月1日～2024年3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	220,000	4.4	25,000	△28.7	26,000	△38.7	15,000	△49.5	319.07

（注）直前に公表されている業績予想からの修正の有無：有

※ 注記事項

（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無  
新規 -社（社名）-、除外 -社（社名）-

（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有

（注）詳細は、添付資料8ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：無
- ② ①以外の会計方針の変更：無
- ③ 会計上の見積りの変更：無
- ④ 修正再表示：無

（4）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2024年3月期3Q	47,111,567株	2023年3月期	47,011,067株
② 期末自己株式数	2024年3月期3Q	99,334株	2023年3月期	94,305株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2024年3月期3Q	46,954,288株	2023年3月期3Q	45,806,551株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(会計方針の変更)	8
(セグメント情報等)	9

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間における経営環境については、米国景気は良好な雇用・所得環境を背景に個人消費が堅調ですが、製造業の調整、設備投資低迷が継続しております。米国金利については徐々に抑制されるよう方向転換が見られました。欧州も米国と同様、ユーロ圏を中心に景気の下押しを避けるよう利上げの打ち止めを表明しております。日本は緩やかな景気回復が続く一方、燃料を中心に輸入品などの価格高騰も継続しております。また、年始の能登半島地震発生は北陸地方の経済活動に懸念をもたらしております。中国は政府による金融緩和や財政支出等の効果もあり下支えされていますが、世界的な財需要の低迷などのあおりを受け、輸出の伸び悩みが続くなど、比較的厳しい経済状況が続いております。

為替相場は、対米ドルレートは春以降円安方向に転じて以降、一進一退ありながらも円安が続いております。

当社グループの属するエレクトロニクス産業では、半導体産業の需要調整局面が続き、半導体製造装置の需要も高水準であった前年度と比較して需要が低迷しております。一方、パワー半導体の市場は比較的堅調に推移しております。

このような事業環境のなか、当社グループの半導体等装置関連事業では、製造装置向けの真空部品や受託加工、及び半導体製造プロセス向けの各種マテリアル製品（石英製品・セラミックス製品・シリコンパーツ等）などは欧米顧客向けの売上が伸び悩むなか、中国顧客向け（半導体装置向けや太陽光パネル向けなど）売上が下支えをしました。製品分野ではCVD-SiC製品や石英坩堝が他事業をカバーしました。

電子デバイス事業では、サーモモジュールの事業の伸び悩みをパワー半導体用基板による産業機器向け及びEV（電気自動車）向けの販売がカバーする状況が続いております。

なお、営業利益は、減価償却費負担増や販売費及び一般管理費の増加もあり前年同期比で減少しました。経常利益は当第3四半期累計期間の為替差益1,829百万円の発生が利益を押し上げたものの、前年同期に発生した為替差益6,979百万円との比較では大きく減少しました。

この結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は168,266百万円（前年同期比8.1%増）、営業利益は20,926百万円（前年同期比21.8%減）、経常利益は23,266百万円（前年同期比34.1%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は13,464百万円（前年同期比43.3%減）となりました。

当第3四半期連結累計期間のセグメントの経営成績は、以下のとおりです。

#### (半導体等装置関連事業)

当該事業の主な製品は、真空シール及び各種製造装置向け金属加工製品、石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC製品、シリコンパーツ、装置部品洗浄、石英坩堝などです。

当社の真空シールおよび各種製造装置向け金属加工製品や半導体製造プロセスに使用されるマテリアル製品（石英製品・セラミックス製品・シリコンパーツ等）、部品洗浄サービスは、半導体の在庫調整局面にあり、設備投資需要の停滞及び設備稼働率の低下の影響で売上が減少しました。中国ローカルの装置メーカー向けの売上を維持し、欧米メーカーの売上減少をカバーしております。一方、石英坩堝は太陽光パネル製造メーカー向けの売上が引き続き伸びました。マテリアル製品のうち受注残を持つCVD-SiC製品も売上増を継続しました。

この結果、当該事業の売上高は97,494百万円（前年同期比1.7%減）、営業利益は13,163百万円（前年同期比27.5%減）となりました。

#### (電子デバイス事業)

当該事業の主な製品は、サーモモジュール、パワー半導体用基板、磁性流体、センサなどです。

サーモモジュールは、PCR検査装置を中心に医療関係向けの出荷が減少したことが主要因で売上減となりました。一方、パワー半導体用基板は、産業機械向けを中心にDCB基板の販売が好調であったこと、加えて中国のEV車向けを中心にAMB基板が引き続き伸びたこともあり、全体でも大きく売上を伸ばしました。また、センサは前第2四半期連結会計期間より株式会社大泉製作所を連結化したため、対前年同期比では連結化していなかった期間との比較で売上等が増加しております。

この結果、当該事業の売上高は50,370百万円（前年同期比32.0%増）、営業利益は8,711百万円（前年同期比1.9%増）となりました。

(その他)

「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

工作機械は前年同期比で出荷が減少しました。また、ソーブレードには前第2四半期連結会計期間より連結化した東洋刃物株式会社の売上、利益が、前第3四半期連結会計期間より含み、対前年同期比では連結化していなかった期間との比較で売上等が増加しております。

この結果、当該事業の売上高は20,401百万円（前年同期比11.0%増）、営業損失は22百万円（前年同期は営業利益668百万円）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

<資産>

当第3四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比べ98,028百万円増加し、508,676百万円となりました。これは主に現金及び預金23,054百万円、受取手形、売掛金及び契約資産8,731百万円、有形固定資産49,130百万円の増加によるものであります。

<負債>

当第3四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ65,435百万円増加し、226,427百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金2,109百万円の減少があった一方、転換社債型新株予約権付社債25,000百万円、長期借入金（1年内返済予定を含む）40,547百万円の増加によるものであります。

<純資産>

当第3四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ32,592百万円増加し、282,249百万円となりました。これは主に利益剰余金8,534百万円、為替換算調整勘定15,968百万円、非支配株主持分6,819百万円の増加によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2023年11月14日に公表いたしました通期の業績予想を修正しております。

なお、詳細につきましては、本日公表いたしました「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	103,115	126,170
受取手形、売掛金及び契約資産	53,276	62,008
商品及び製品	12,059	16,849
仕掛品	13,505	14,731
原材料及び貯蔵品	23,613	27,037
その他	9,955	13,368
貸倒引当金	△184	△186
流動資産合計	215,341	259,977
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	38,080	55,134
機械装置及び運搬具（純額）	44,171	53,922
工具、器具及び備品（純額）	5,984	6,912
土地	4,451	4,742
リース資産（純額）	11,009	12,264
建設仮勘定	35,913	55,764
有形固定資産合計	139,610	188,740
無形固定資産		
のれん	2,304	2,148
その他	4,645	4,687
無形固定資産合計	6,949	6,835
投資その他の資産		
関係会社株式	33,893	35,795
その他	15,489	18,020
貸倒引当金	△636	△694
投資その他の資産合計	48,745	53,121
固定資産合計	195,306	248,698
資産合計	410,648	508,676

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	40,524	38,415
電子記録債務	3,372	4,243
短期借入金	20,378	20,525
1年内償還予定の社債	4,723	4,422
1年内返済予定の長期借入金	11,102	15,197
未払法人税等	2,432	2,406
賞与引当金	2,913	3,106
その他	25,847	27,176
流動負債合計	111,294	115,491
固定負債		
社債	4,083	660
転換社債型新株予約権付社債	—	25,000
長期借入金	26,432	62,885
退職給付に係る負債	2,020	1,806
資産除去債務	348	408
その他	16,812	20,174
固定負債合計	49,697	110,935
負債合計	160,991	226,427
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	29,425	29,539
資本剰余金	67,961	68,737
利益剰余金	69,656	78,191
自己株式	△88	△88
株主資本合計	166,955	176,379
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	272	597
為替換算調整勘定	16,477	32,446
退職給付に係る調整累計額	23	118
その他の包括利益累計額合計	16,773	33,162
新株予約権	40	—
非支配株主持分	65,887	72,706
純資産合計	249,656	282,249
負債純資産合計	410,648	508,676

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
 (四半期連結損益計算書)  
 (第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
売上高	155,690	168,266
売上原価	101,316	113,841
売上総利益	54,373	54,424
販売費及び一般管理費	27,630	33,498
営業利益	26,743	20,926
営業外収益		
受取利息	527	1,410
補助金収入	2,063	2,405
為替差益	6,979	1,829
その他	645	783
営業外収益合計	10,215	6,428
営業外費用		
支払利息	827	1,248
持分法による投資損失	186	2,479
その他	663	360
営業外費用合計	1,677	4,087
経常利益	35,281	23,266
特別利益		
持分変動利益	649	710
段階取得に係る差益	204	—
特別利益合計	853	710
特別損失		
固定資産処分損	86	123
投資有価証券評価損	—	511
減損損失	—	34
災害による損失	325	—
段階取得に係る差損	702	—
特別損失合計	1,115	669
税金等調整前四半期純利益	35,019	23,308
法人税等	8,161	5,222
四半期純利益	26,857	18,085
非支配株主に帰属する四半期純利益	3,120	4,621
親会社株主に帰属する四半期純利益	23,737	13,464



## (四半期連結包括利益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
四半期純利益	26,857	18,085
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△135	325
為替換算調整勘定	18,453	18,098
退職給付に係る調整額	89	94
持分法適用会社に対する持分相当額	4,193	2,741
その他の包括利益合計	22,601	21,260
四半期包括利益	49,459	39,345
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	40,674	29,853
非支配株主に係る四半期包括利益	8,784	9,492

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また、見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

## 【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体等 装置関連事業	電子デバ イス事業	計				
売上高							
(1)外部顧客への 売上高	99,154	38,159	137,314	18,376	155,690	—	155,690
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—
計	99,154	38,159	137,314	18,376	155,690	—	155,690
セグメント利益	18,161	8,553	26,714	668	27,383	△639	26,743

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額△639百万円には、セグメント間取引の消去1百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用637百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体等 装置関連事業	電子デバ イス事業	計				
売上高							
(1)外部顧客への 売上高	97,494	50,370	147,864	20,401	168,266	—	168,266
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	—	—	—	41	41	△41	—
計	97,494	50,370	147,864	20,443	168,308	△41	168,266
セグメント利益又 は損失(△)	13,163	8,711	21,875	△22	21,853	△926	20,926

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

2 セグメント利益又は損失(△)の調整額△926百万円には、セグメント間取引の消去853百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用73百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。